

2-1-2-27 SR 下地糊状異物付着／SR 基底附着粘性杂物／Pasty foreign material under solder resist

【特徴】SR印刷前の銅箔面や基板樹脂面に糊や粘土状異物が残っている状態の欠陥

【特征】SR印刷前の銅箔面或者樹脂面残存胶或者粘性杂物的缺陷。

【Characteristics】Adhesive or a clay-like foreign material is left on the copper foil surface or the laminate surface of a board before solder resist application.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷前整面後の板面に糊や粘土状異物が付着して出来たもの（SR印刷前整面～SR印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】在SR印刷前表面处理后的板面附着胶或者粘性杂物而引起的（表面处理～SR印刷工序）。

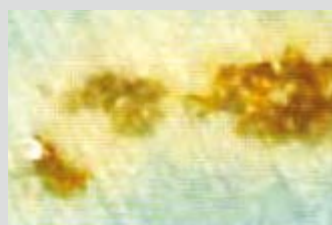
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by the attachment of an adhesive or a clay-like foreign material to the board surface in a process from board abrasion to solder resist printing (Surface cleaning - solder resist printing process)



【コメント】顕微鏡倍率×50

【注釋】显微镜倍率×50

【Comments】Magnification: ×50



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

2-1-2-28 SR 下地指紋汚れ／SR 基底の指紋玷污／Fingerprint on base material under solder resist

【特徴】SRの下地に指紋汚れが残っている状態の欠陥

【特征】在SR的基底留下指纹玷污的缺陷。

【Characteristics】A fingerprint is left on the base material under solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷前整面で除去し切れなかった指紋汚れや、整面後に板面に触って出来た指紋が残って出来たもの（SR印刷前工程）

【原因、判断要点、发生工序】在SR印刷前的表面处理时不能完全地清除指纹的玷污，或者表面处理时触摸板面留下指纹所引起的（SR印刷前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by a fingerprint not completely removed by surface abrasion before solder resist application or a fingerprint printed after surface cleaning by touching the board surface (Before solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×